

证券代码：301369

证券简称：联动科技

佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：投 2024-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、天风证券 骆奕扬 2、易方达基金 姚欢宸 3、创金合信基金 郭镇岳 4、创富兆业 刘姝仪
时间	2024年10月30日（周三）下午 15:30-17:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 邱少媚女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>（1）主营产品介绍</p> <p>公司成立于1998年，一直专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售。公司具备较为完善的产品线，主要包括半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备、其他机电一体化设备，此外还有相应配件、维修服务等。公司的半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数，包括功率半导体的测试、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试；激光打标设备主要用于半导体芯片的打标。</p> <p>成立后，公司最早进入的是激光打标领域，于2001年推出首款激光打标设备，主要用于半导体分立器件的打标。得益于优异的产品性能，迅速得到了半导体封测头部客户的认可。彼时国内半导体测试设备行业还处于发展早期，国内厂商主要用的是国外进口设备，价格较高，公司看到了半导体测试设备领域的机会，凭借激光打标设备积累的客户资源、封测产线应用经验以及工业控制技术，自2003年起开始进入分立器件测试系统领域，通过多年深耕封测行业的经验与技术积累，目前已经拥有自主研发的功率半导体</p>

及小信号分立器件测试系统产品包括 QT-3000/4000/5000/6000/8400 系列，涵盖小信号分立器件及中高功率半导体测试，包括二极管、三极管、MOSFET、IGBT、可控硅、SiC 和 GaN 第三代半导体等，以及功率模块的晶圆测试、KGD 测试及出厂测试，并已实现了产品的国际化布局。

公司 QT-4000 系列功率器件综合测试平台，主要针对功率器件测试，能满足高压源、超大电流源等级的功率器件测试要求，能够实现半导体器件直流参数测试项目和动态参数测试项的一对一数据合并，同时能够分别实现小信号分立器件和中大功率器件的多工位并行测试要求，带来测试精度、测试效率及数据分析管理效率的大大提高，顺应了市场变化趋势，深受市场主流功率半导体客户的认可，是公司销量较高的产品之一，是公司收入的重要来源。

公司的 Q-6000 系列产品是针对小信号分立器件的测试，能够满足小信号器件多工位并行测试要求，最大的特点是测试速度很快，测试 UPH 值可达 60k，达到国际先进水平。

随着功率器件 CP 测试（晶圆测试）的需求逐渐增多，为了提升测试效率，客户对测试系统的并行测试能力不断提高。针对功率半导体和第三代半导体器件测试带来的新的测试需求，公司推出了新产品 QT-8400 系列功率测试平台，是公司在功率半导体测试系统产品上的重要创新，在技术架构和设计理念上与集成电路测试系统有诸多共通之处，主要用于 IGBT 及第三代半导体碳化硅和氮化镓功率器件和晶圆测试及功率模块的全性能测试，能够满足电动汽车、新能源等工业领域日益增长的测试需求和新的应用场景。

（2）产品应用环节

公司产品主要应用于半导体生产前道工序中的晶圆测试环节，以及后道工序中框架或裸晶激光打标、KGD 测试、成品测试、激光打标/视觉检测等环节。

二、问答环节

1、公司对四季度及未来行业有什么计划和展望？

回复：今年四季度公司计划将继续努力提升经营质量，加大技术创新，进一步提升公司的市场竞争能力，争取完成四季度以及全年的营收目标。

从下游需求端来看，碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，产业正在飞速发展。与传统的硅半导体相比，碳化硅半导体能够在更高的温度和更高的电压下工作。随着碳化硅产业链各环节良率不断提升、衬底尺寸从 6 英寸转 8 英寸，产业链技术进步及生产效率提高，碳化硅在未来将

得到更广泛的应用,尤其是在电动汽车、光伏新能源等快速增长领域。随着未来碳化硅技术的不断发展和应用领域的扩大,相关配套的测试设备也必须进行相应的技术革新和功能提升,以适应市场的需求。这对测试机厂商是一个挑战,也是测试机厂商发展中的一个重要市场机遇。

2、请介绍公司下游客户情况?

回复:公司主要客户包括了国内外知名的功率半导体 IDM 厂商,如芯联集成、安森美集团、比亚迪半导体、三安光电等,以及封测领域龙头企业,如安靠集团、长电科技、通富微电、华天科技等。公司产品已经覆盖优质广阔的客户群,拥有较高的客户进入壁垒,处于领先的市场地位。近几年,随着新能源、电动汽车等新的应用领域的发展,公司的客户结构也有发生一些变化,以前以半导体封测厂商客户为主,现在以 IDM 模式的功率半导体厂商客户为主。

3、请问公司未来投资并购计划?

回复:目前公司的主要精力还是做好主业,同时关注长远发展和资金的使用效率,也有留意合适的投资标的,在合适的时机,寻求产业整合度较高的并购标的做一些上下游或横向并购的尝试。

4、请问公司在新产品方面的规划和布局?

回复:未来公司将重点推进在功率半导体测试领域、KGD 测试领域、大规模数字和 Soc 类集成电路测试系统等相关产品及技术应用方案的持续迭代升级及研发。

KGD 测试是新的工艺环节,有利于保证芯片的良率、降低成本、提高测试效率。这两年,公司关注到部分下游客户对于 KGD 测试需求在逐渐增加,公司针对 KGD 测试方案已和部分海内外知名客户进行合作,未来,随着 KGD 测试需求的进一步增长,公司在该领域的市场份额也会得到更多的发展机会。

另外,公司面向数字及部分 Soc 类芯片的测试需求的大规模数字集成电路测试系统目前仍在研发中,计划尽快完成样机并推向市场。未来大规模数字集成电路测试机台的推出及量产,将有助于增强公司在中高端测试机领域的竞争力和市场覆盖。

5、公司预计未来业务增量主要是来自哪些产品?

回复:公司未来业务增量主要还是来源于功率半导体测试系统,公司在功率半导体测试领域具有技术上的优势和扎实的业务基础。未来随着人工智能技术的快速发展,有望带动消费电子需求增长,加快消费电子产品的更新换代,这对于公司模拟及数模混合集成电路测试系统以及小信号

	<p>分立器件测试系统业务的拓展也将是一个重要的市场机会。</p> <p>6、如何看待国内半导体测试设备国产替代的进程？</p> <p>回复：半导体测试设备的国产替代是我国半导体产业发展的重要环节，但半导体测试机设备的国产替代不是短期内就能完成的任务，因为国产替代不仅仅是替换进口设备那么简单，而是需要在多个层面上实现技术自主和创新。只有通过逐步的技术积累和创新，国产半导体测试设备才能真正达到国际先进水平，从而实现从依赖到自给自足的转变。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 30 日